



Dresden/New York City, den 27. März 2012

Technologie/ Wissenschaft/ Gesellschaft

## Terminhinweis – Save the Date

---

# IEEE Technology Time Machine (TTM) – 23. bis 25. Mai 2012 in Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
hiermit möchten wir Sie auf eine Veranstaltung Ende Mai in Dresden hinweisen:

## IEEE Technology Time Machine (TTM) – Symposium on Technologies Beyond 2020

Das Symposium „Technology Time Machine“ bringt rund 300 CEOs, CTOs, CIOs und führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt an Europas führendem Cluster für Mikro- und Nanoelektronik, dem Silicon Saxony, zusammen. Alle verbindet ihre tägliche Arbeit: die Entwicklung intelligenter Zukunftstechnik.

Erklärtes Ziel ist es, fachübergreifend über gesellschaftliche Auswirkungen neuer Technologien zu diskutieren und sich darüber auszutauschen, welchen Beitrag Zukunftstechnologien im Kontext der großen globalen Herausforderungen unserer Zeit leisten.

**Topthemen u.a.:** Kollektive Intelligenz, Intelligente Energieversorgung, Internet der Dinge (Cyber Physical Systems), Zukünftige Technologien der Medizintechnik, Intelligente Transport- und Logistiksysteme, Moderne Kommunikationsnetze, Mikroelektronik der Zukunft, Virtualisierung und Sicherheit (Cloud Computing und Security).

**Top-Akteure u.a.:** Google, IBM, DLR, NASA, Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent, Telx, SAP, Actix, ZMDI, Kofler Energies, Siemens, Enel, Associated Press, Vodafone, Infineon, Tata Motors, Giesecke & Devrient, Sensys Networks, Oracle, EIT ICT Labs, Foster+Partners, Volkswagen, National Instruments, VDE und Fraunhofer HHI, FOKUS, IIS sind mit ihren Führungskräften und technologischen Vordenkern in Dresden.

Das „Technology Time Machine“ ist ein jährlich stattfindendes internationales Symposium. Im Jahr 2011 war die Stadt Hongkong Gastgeber.

**Mehr Informationen und Anmeldung:** <http://ttm.ieee.org>

### Informationen zur Organisation und Sponsoring:

**Technische Universität Dresden**, Sebastian Zaunseder, Telefon: +49 351 463 33786, [ttminfo@ieee.org](mailto:ttminfo@ieee.org)

### Medienkontakt:

**Technische Universität Dresden**, Kim-Astrid Magister, Pressesprecherin,  
Telefon: +49 (351) 463-32398, [kim-astrid.magister@tu-dresden.de](mailto:kim-astrid.magister@tu-dresden.de)

**PR-Piloten GmbH & Co. KG**, Robert Weichert, Telefon: +49 351 50 14 02 02, [info@pr-piloten.de](mailto:info@pr-piloten.de)

### Über IEEE

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ist mit mehr als 400.000 Mitgliedern in über 150 Ländern der weltweit größte technische Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen Elektrotechnik und Informatik mit Sitz in New York City. Der Verband gliedert sich in zahlreiche Fachgesellschaften (Societies), die sich mit dem gesamten Spektrum der Elektro- und Informationstechnik auseinandersetzen und die Standardisierung von Techniken, Hardware und Software weltweit vorantreiben. Darüber hinaus ist IEEE Veranstalter von Fachtagungen und Herausgeber diverser Fachzeitschriften. Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften oder zu Konferenzen des IEEE sind im Allgemeinen von besonders hoher fachlicher Güte. Mit Veröffentlichungen wie der Zeitschrift IEEE Spectrum setzt sich die Organisation auch für eine fachübergreifende Information und die Diskussion der gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien ein.

RÜCKANTWORT

## IEEE Technology Time Machine (TTM) – Symposium on Technologies Beyond 2020

23. bis 25. Mai 2012 in Dresden

Bitte senden Sie dieses Antwortschreiben an:

PR-Piloten GmbH & Co. KG  
Robert Weichert/ Ulf Mehner  
E-Mail: info@pr-piloten.de

**Fax: +49 351 50 14 02 09**

Von:

Medium:

---

Name,  
Vorname

---

Adresse:

---

PLZ/Ort:

---

Tel:

---

Fax:

---

E-Mail:

---

- Wir sind thematisch an der Veranstaltung interessiert und freuen uns über weiteres Infomaterial.
- Wir sind an einem Interview mit Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fettweis, Vodafone Chair Mobile Communications Systems, Technische Universität Dresden, interessiert.
- Wir würden uns gern für die Veranstaltung akkreditieren.
- Wir können leider nicht kommen, freuen uns aber über Infomaterial.

.....  
(Unterschrift)